

ハロゲンフリー対応 Halogen Free

層間絶縁材料 EZ Series

Dielectric Materials "EZ" Series

FBR-EZ77

樹脂フィルム Resin Film

CBR-EZ78

RCC

屈曲可能、高Tgでポリイミド、アルミなどへ接着強度が強く、しかもハロゲンフリーの層間絶縁材料です。

Flexible, High Tg, High Peel Strength to Poly-imide, Aluminium etc and Halogen Free Dielectric Materials.

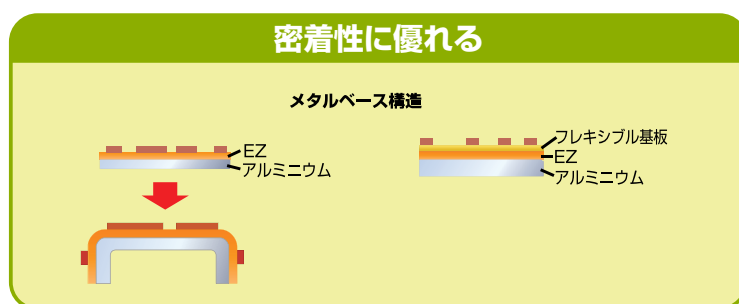
特長

- 高 Tg で、ポリイミド、アルミ、銅などへの接着強度が強くなっています。
- 適度の屈曲性があります。
- ハロゲンフリーで耐燃性を有します。
- 低 C.T.E です。
- 耐マイグレーション性などの信頼性に優れます。

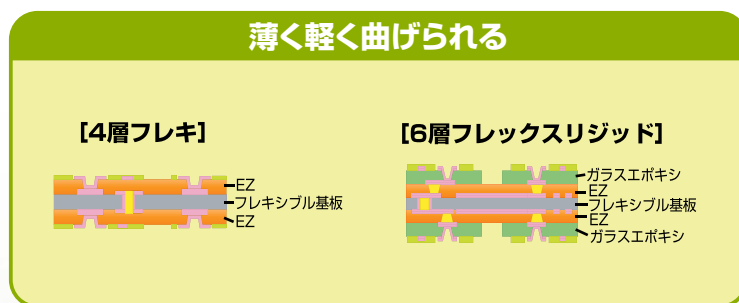
FEATURES

- High Tg and Excellent Peel Strength to PI Film, Aluminium, Copper Foil etc.
- Moderate Flexibility.
- Halogen Free and Non-Flammability.
- Low C.T.E.
- The Reliability of the Migration Resistance is so High.

密着性に優れる



薄く軽く曲げられる



項目 ITEM	条件 Conditions	単位 Units	樹脂フィルム Resin Film	RCC
			FBR-EZ77	CBR-EZ78
ガラス転移温度 Tg (TMA)	A	℃	175	154
熱膨張係数 C.T.E		α_1	59	62
フィルム物性 Film Properties		引張り弾性率 Tensile Modulus	1.9	1.8
		引張り破断強度 Breaking Strength	94	70
		引張り破断伸び Breaking Strain	9.6	8.1
引き剥がし強さ Peel Strength	銅箔 Copper Foil	マット面 Mat Side	1.2	1.2
		CZ面 CZ Side	0.8	0.78
		ポリイミド(無表面処理) Polyimide	0.6	0.6
		アルミ(表面処理) Aluminium	>2.0	>2.0
MIT屈曲性(R=0.38) Folding Endurance	20℃	回 times	262 (フィルム50μm) (Film 50μm)	368 (フィルム50μm) (Film 50μm)
耐燃性(UL94) Flammability(UL94)	A	—	ハロゲンフリー Halogen Free VTM-0相当	ハロゲンフリー Halogen Free VTM-0相当